

ANPシリーズ ANP-1 は「無加圧」接合に対応。Ni・Cu への接合も可能

Properties	ANP-1	ANP-8	Remarks
Viscosity	50~300Pa・s	50~300Pa・s	調整可能
Sintering Temperature	250℃ ↑ x300sec	300℃ ↑ x300sec	設備や試料の状態によって変化します。
Sintering Pressure	10MPa ↑	20MPa ↑	
Thermal conductivity (W/m・K)	330W/m・K	350W/m・K	弊社推奨条件焼成時
Shear Strength	40MPa	40MPa	
Target Metal	Ag,Au,Cu,Ni,Pd,Pt	Ag,Au,Cu,Ni,Pd,Pt	

ASTROシリーズ

予備乾燥後の仮固定が可能

ASTRO-HP	
Viscosity	10~100Pa・s
Sintering Temperature	250℃ ↑ x300sec
Sintering Pressure	10MPa ↑
Thermal Conductivity (W/m・K)	330W/m・K
Shear Strength	30MPa
Target Metal	Ag,Au,Cu,Pd,Pt

従来よりも低温での接合を実現

ASTRO-MP	
Viscosity	10~100Pa・s
Sintering Temperature	230℃ ↑ x300sec
Sintering Pressure	20MPa ↑
Thermal Conductivity (W/m・K)	測定中
Shear Strength	30MPa
Target Metal	Ag,Au,Pd,Pt

ASTRO-LP	
Viscosity	10~100Pa・s
Sintering Temperature	220℃ ↑ x300sec
Sintering Pressure	10MPa ↑
Thermal Conductivity (W/m・K)	350W/m・K
Shear Strength	20MPa
Target Metal	Ag,Au,Pd,Pt,(Cu)

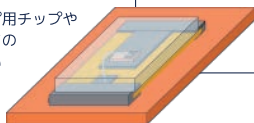
TIM用途

グリスやシートでは足りない
高熱伝導率が必要なモジュールへ

加圧できないデバイス用途

バインドレス / 無加圧接合

高周波アンプ用チップや
発光素子などの
加圧できない
デバイスの
接合に最適



ASTRO-LN	
Viscosity	10~300Pa・s
Sintering Temperature	250℃ ↑ x 60min
Sintering Pressure	0MPa
Thermal Conductivity (W/m・K)	155W/m・K
Shear Strength	20MPa
Target Metal	Ag,Au,Pd,Pt

ダイアタッチ用途

